

2021年中国半导体晶圆加工设备行业分析报告- 产业规模与发展规划趋势

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2021年中国半导体晶圆加工设备行业分析报告-产业规模与发展规划趋势》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/bandaoti/551265551265.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

半导体晶圆加工设备行业具有较强的周期性，总体受宏观经济周期与技术更新迭代影响，呈现出波动上升的发展态势。作为计算机、信息通信、电子产品、物联网等领域的核心组成部分，半导体晶圆加工设备行业是现代电子信息社会发展的基石，其技术水平与发展规模已成为衡量一个国家综合国力和产业竞争力的重要标准之一。

1、我国半导体晶圆加工设备行业主管部门与监管体制

我国半导体晶圆加工设备行业的政府主管部门为工信部、科技部，行业自律性组织为中国半导体行业协会。其主要职能如下：

主管部门/监管体制

主要职责

工信部

拟定实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。

科技部

拟订国家创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施；统筹推进国家创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；牵头建立统一的国家科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制；拟订国家基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调国家重大基础研究和应用基础研究；编制国家重大科技项目规划并监督实施；牵头国家技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施等。

中国半导体行业协会

主要负责贯彻落实政府产业政策；开展产业及市场研究，向会员单位和政府主管部门提供咨询服务；行业自律管理；代表会员单位向政府部门提出产业发展建议和意见等。资料来源：

观研天下整理

2. 我国半导体晶圆加工设备行业主要法律法规与产业政策

行业内的主要法律法规和相关产业政策如下：

时间

部门

名称

主要内容

2011.01

国务院

《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》

为进一步优化软件产业和集成电路产业发展环境，提高产业发展质量和水平，培育一批有实

力和影响力的行业领先企业，在财税、投融资、研究开发、进出口等各方面制定了许多优惠政策。在投融资方面，积极支持符合条件的软件企业和集成电路企业采取发行股票、债券等多种方式筹集资金，拓宽直接融资渠道。

2011.05

海关总署

《关于对海关支持软件产业和集成电路产业发展的有关政策规定和措施》（海关总署公告2011年第30号）

明确了经认定的软件企业进口所需的自用设备以及配套件、备件可以免征进口关税，照章征收进口环节增值税。经认定线宽小于0.25微米或投资额超过80亿元人民币的集成电路生产企业和经认定的线宽小于0.8微米（含）的集成电路生产企业，其进口自用生产性原材料、消耗品，净化室专用建筑材料、配套系统，以及集成电路生产设备零、配件可以免征关税和进口环节增值税。

2012.04

财政部、国家税务总局

《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）

我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。

2012.08

国家发改委、工信部、财政部、商务部、国家税务总局

《国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业认定管理试行办法》

规划布局企业须符合战略性新兴产业发展规划、信息产业发展规划等国家规划部署，在全国软件和集成电路行业中具有相对比较优势。

2014.06

国务院

《国家集成电路产业发展推进纲要》

提出着力发展集成电路设计业；加速发展集成电路制造业；提升先进封装测试业发展水平；突破集成电路关键装备和材料；并从成立国家集成电路产业发展领导小组、设立国家产业投资基金、加大金融支持力度、落实税收支持政策、加强安全可靠软硬件的推广应用、强化企业创新能力建设、加大人才培养和引进力度、继续扩大对外开放等八个方面配备了相应的保障措施。

2015.02

财政部、国家税务总局、国家发改委、工信部

《关于进一步鼓励集成电路产业发展企业所得税政策的通知》

明确了享受两免三减半企业所得税优惠条件的集成电路、测试企业、集成电路关键专用生产企业或集成电路专用设备生产企业的条件，从所得税优惠层面助推集成电路发展。

2015.05

国务院

《中国制造2025》

着力提升集成电路设计水平，不断丰富知识产权（IP）和设计工具，突破关系国家信息与网络安全及电子整机产业发展的核心通用芯片，提升国产芯片的应用适配能力。掌握高密度封装及三维（3D）微组装技术，提升封装产业和测试的自主发展能力。形成关键制造装备供货能力。

2016.05

财政部、国家税务总局、国家发改委、工信部

《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号）

明确了在集成电路企业的税收优惠资格认定等非行政审批取消后，规定集成电路设计企业可以享受《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）有关企业所得税减免政策需要的条件，再次从税收政策上支持集成电路设计行业的发展。

2017.01

国家发改委

《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》

将集成电路设备列入战略性新兴产业重点产品目录。

2017.09

国务院办公厅

《国务院办公厅关于进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的指导意见》（国办发[2017]79号）

提出发挥财政性资金带动作用，通过投资补助、资本金注入、设立基金等多种方式，广泛吸纳各类社会资本，支持企业加大技术改造力度，加大对集成电路等关键领域和薄弱环节重点项目的投入。

2018.01

财政部、国家税务总局、国家发改委、工信部

《财政部税务总局国家发展改革委工业和信息化部关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》（财税

[2018]27号）

规定了不同纳米级别、经营期限和投资规模的集成电路生产企业的企业所得税的优惠政策，从税收政策上支持集成电路生产企业的发展。

2020.07

国务院

《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》

为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量，制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施。

2020.12

财政部、国家税务总局、国家发改委、工信部

《财政部税务总局发展改革委工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（

财政部税务总局发展改革委工业和信息化部公告2020年第45号）

为促进集成电路产业和软件产业高质量发展，就有关企业所得税政策问题发出的公告。规定了不同纳米级别、经营期限和投资规模的集成电路生产企业的企业所得税的优惠政策，从税收政策上支持集成电路生产企业的发展。资料来源：观研天下整理（CT）

观研报告网发布的《2021年中国半导体晶圆加工设备行业分析报告-产业规模与发展规划趋势》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【目录大纲】

第一章 2017-2021年中国半导体晶圆加工设备行业发展概述

第一节 半导体晶圆加工设备行业发展情况概述

- 一、半导体晶圆加工设备行业相关定义
- 二、半导体晶圆加工设备行业基本情况介绍
- 三、半导体晶圆加工设备行业发展特点分析
- 四、半导体晶圆加工设备行业经营模式
 - 1、生产模式
 - 2、采购模式
 - 3、销售模式
- 五、半导体晶圆加工设备行业需求主体分析

第二节 中国半导体晶圆加工设备行业上下游产业链分析

- 一、产业链模型原理介绍
- 二、半导体晶圆加工设备行业产业链条分析
- 三、产业链运行机制
 - (1) 沟通协调机制
 - (2) 风险分配机制
 - (3) 竞争协调机制
- 四、中国半导体晶圆加工设备行业产业链环节分析
 - 1、上游产业
 - 2、下游产业

第三节 中国半导体晶圆加工设备行业生命周期分析

- 一、半导体晶圆加工设备行业生命周期理论概述
- 二、半导体晶圆加工设备行业所属的生命周期分析

第四节 半导体晶圆加工设备行业经济指标分析

- 一、半导体晶圆加工设备行业的赢利性分析
- 二、半导体晶圆加工设备行业的经济周期分析
- 三、半导体晶圆加工设备行业附加值的提升空间分析

第五节 中国半导体晶圆加工设备行业进入壁垒分析

- 一、半导体晶圆加工设备行业资金壁垒分析
- 二、半导体晶圆加工设备行业技术壁垒分析
- 三、半导体晶圆加工设备行业人才壁垒分析
- 四、半导体晶圆加工设备行业品牌壁垒分析
- 五、半导体晶圆加工设备行业其他壁垒分析

第二章 2017-2021年全球半导体晶圆加工设备行业市场发展现状分析

第一节 全球半导体晶圆加工设备行业发展历程回顾

第二节 全球半导体晶圆加工设备行业市场区域分布情况

第三节 亚洲半导体晶圆加工设备行业地区市场分析

- 一、亚洲半导体晶圆加工设备行业市场现状分析
- 二、亚洲半导体晶圆加工设备行业市场规模与市场需求分析
- 三、亚洲半导体晶圆加工设备行业市场前景分析

第四节 北美半导体晶圆加工设备行业地区市场分析

- 一、北美半导体晶圆加工设备行业市场现状分析
- 二、北美半导体晶圆加工设备行业市场规模与市场需求分析
- 三、北美半导体晶圆加工设备行业市场前景分析

第五节 欧洲半导体晶圆加工设备行业地区市场分析

- 一、欧洲半导体晶圆加工设备行业市场现状分析
- 二、欧洲半导体晶圆加工设备行业市场规模与市场需求分析
- 三、欧洲半导体晶圆加工设备行业市场前景分析

第六节 2021-2026年世界半导体晶圆加工设备行业分布走势预测

第七节 2021-2026年全球半导体晶圆加工设备行业市场规模预测

第三章 中国半导体晶圆加工设备产业发展环境分析

第一节 我国宏观经济环境分析

- 一、中国GDP增长情况分析
- 二、工业经济发展形势分析
- 三、社会固定资产投资分析
- 四、全社会消费品零售总额
- 五、城乡居民收入增长分析
- 六、居民消费价格变化分析
- 七、对外贸易发展形势分析

第二节 中国半导体晶圆加工设备行业政策环境分析

- 一、行业监管体制现状
- 二、行业主要政策法规

第三节 中国半导体晶圆加工设备产业社会环境发展分析

- 一、人口环境分析
- 二、教育环境分析
- 三、文化环境分析
- 四、生态环境分析
- 五、消费观念分析

第四章 中国半导体晶圆加工设备行业运行情况

第一节 中国半导体晶圆加工设备行业发展状况情况介绍

一、行业发展历程回顾

二、行业创新情况分析

1、行业技术发展现状

2、行业技术专利情况

3、技术发展趋势分析

三、行业发展特点分析

第二节 中国半导体晶圆加工设备行业市场规模分析

第三节 中国半导体晶圆加工设备行业供应情况分析

第四节 中国半导体晶圆加工设备行业需求情况分析

第五节 我国半导体晶圆加工设备行业细分市场分析

1、细分市场一

2、细分市场二

3、其它细分市场

第六节 中国半导体晶圆加工设备行业供需平衡分析

第七节 中国半导体晶圆加工设备行业发展趋势分析

第五章 中国半导体晶圆加工设备所属行业运行数据监测

第一节 中国半导体晶圆加工设备所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节 中国半导体晶圆加工设备所属行业产销与费用分析

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

第三节 中国半导体晶圆加工设备所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第六章 2017-2021年中国半导体晶圆加工设备市场格局分析

第一节 中国半导体晶圆加工设备行业竞争现状分析

一、中国半导体晶圆加工设备行业竞争情况分析

二、中国半导体晶圆加工设备行业主要品牌分析

第二节 中国半导体晶圆加工设备行业集中度分析

一、中国半导体晶圆加工设备行业市场集中度影响因素分析

二、中国半导体晶圆加工设备行业市场集中度分析

第三节 中国半导体晶圆加工设备行业存在的问题

第四节 中国半导体晶圆加工设备行业解决问题的策略分析

第五节 中国半导体晶圆加工设备行业钻石模型分析

一、生产要素

二、需求条件

三、支援与相关产业

四、企业战略、结构与竞争状态

五、政府的作用

第七章 2017-2021年中国半导体晶圆加工设备行业需求特点与动态分析

第一节 中国半导体晶圆加工设备行业消费市场动态情况

第二节 中国半导体晶圆加工设备行业消费市场特点分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三节 半导体晶圆加工设备行业成本结构分析

第四节 半导体晶圆加工设备行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、渠道因素

四、其他因素

第五节 中国半导体晶圆加工设备行业价格现状分析

第六节 中国半导体晶圆加工设备行业平均价格走势预测

一、中国半导体晶圆加工设备行业价格影响因素

二、中国半导体晶圆加工设备行业平均价格走势预测

三、中国半导体晶圆加工设备行业平均价格增速预测

第八章 2017-2021年中国半导体晶圆加工设备行业区域市场现状分析

第一节 中国半导体晶圆加工设备行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地区半导体晶圆加工设备市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区半导体晶圆加工设备市场规模分析

四、华东地区半导体晶圆加工设备市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

- 一、华中地区概述
- 二、华中地区经济环境分析
- 三、华中地区半导体晶圆加工设备市场规模分析
- 四、华中地区半导体晶圆加工设备市场规模预测

第四节 华南地区市场分析

- 一、华南地区概述
- 二、华南地区经济环境分析
- 三、华南地区半导体晶圆加工设备市场规模分析
- 四、华南地区半导体晶圆加工设备市场规模预测

第九章 2017-2021年中国半导体晶圆加工设备行业竞争情况

第一节 中国半导体晶圆加工设备行业竞争结构分析（波特五力模型）

- 一、现有企业间竞争
- 二、潜在进入者分析
- 三、替代品威胁分析
- 四、供应商议价能力
- 五、客户议价能力

第二节 中国半导体晶圆加工设备行业SCP分析

- 一、理论介绍
- 二、SCP范式
- 三、SCP分析框架

第三节 中国半导体晶圆加工设备行业竞争环境分析（PEST）

- 一、政策环境
- 二、经济环境
- 三、社会环境
- 四、技术环境

第十章 半导体晶圆加工设备行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
 - 1、主要经济指标情况
 - 2、企业盈利能力分析
 - 3、企业偿债能力分析
 - 4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第五节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第十一章 2021-2026年中国半导体晶圆加工设备行业发展前景分析与预测

第一节 中国半导体晶圆加工设备行业未来发展前景分析

一、半导体晶圆加工设备行业国内投资环境分析

二、中国半导体晶圆加工设备行业市场机会分析

三、中国半导体晶圆加工设备行业投资增速预测

第二节 中国半导体晶圆加工设备行业未来发展趋势预测

第三节 中国半导体晶圆加工设备行业市场发展预测

一、中国半导体晶圆加工设备行业市场规模预测

二、中国半导体晶圆加工设备行业市场规模增速预测

三、中国半导体晶圆加工设备行业产值规模预测

四、中国半导体晶圆加工设备行业产值增速预测

五、中国半导体晶圆加工设备行业供需情况预测

第四节 中国半导体晶圆加工设备行业盈利走势预测

一、中国半导体晶圆加工设备行业毛利润同比增速预测

二、中国半导体晶圆加工设备行业利润总额同比增速预测

第十二章 2021-2026年中国半导体晶圆加工设备行业投资风险与营销分析

第一节 半导体晶圆加工设备行业投资风险分析

一、半导体晶圆加工设备行业政策风险分析

二、半导体晶圆加工设备行业技术风险分析

三、半导体晶圆加工设备行业竞争风险分析

四、半导体晶圆加工设备行业其他风险分析

第二节 半导体晶圆加工设备行业应对策略

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

第十三章 2021-2026年中国半导体晶圆加工设备行业发展战略及规划建议

第一节 中国半导体晶圆加工设备行业品牌战略分析

一、半导体晶圆加工设备企业品牌的重要性

二、半导体晶圆加工设备企业实施品牌战略的意义

三、半导体晶圆加工设备企业品牌的现状分析

四、半导体晶圆加工设备企业的品牌战略

五、半导体晶圆加工设备品牌战略管理的策略

第二节 中国半导体晶圆加工设备行业市场的关键客户战略实施

一、实施关键客户战略的必要性

二、合理确立关键客户

三、对关键客户的营销策略

四、强化关键客户的管理

五、实施关键客户战略要重点解决的问题

第三节 中国半导体晶圆加工设备行业战略综合规划分析

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第十四章 2021-2026年中国半导体晶圆加工设备行业发展策略及投资建议

第一节 中国半导体晶圆加工设备行业产品策略分析

一、服务产品开发策略

二、市场细分策略

三、目标市场的选择

第二节 中国半导体晶圆加工设备行业营销渠道策略

一、半导体晶圆加工设备行业渠道选择策略

二、半导体晶圆加工设备行业营销策略

第三节 中国半导体晶圆加工设备行业价格策略

第四节 观研天下行业分析师投资建议

一、中国半导体晶圆加工设备行业重点投资区域分析

二、中国半导体晶圆加工设备行业重点投资产品分析

图表详见报告正文

更多好文每日分享，欢迎关注公众号

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/bandaoti/551265551265.html>